

中信建投证券股份有限公司
关于合肥顾中科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：合肥顾中科技股份有限公司
保荐代表人姓名：吴建航	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室
保荐代表人姓名：廖小龙	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕415 号文”批准，合肥顾中科技股份有限公司（以下简称“顾中科技”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股 200,000,000 股。公司本次发行新股的发行价为 12.10 元/股，募集资金总额人民币 2,420,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 187,373,816.76 元后，募集资金净额人民币 2,232,626,183.24 元。本次公开发行股票于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。

经中国证监会“证监许可〔2025〕2298 号文”批准，公司向不特定对象发行 8,500,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 838,790,094.34 元。本次发行证券于 2025 年 11 月 21 日在上海证券交易所上市。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）担任顾中科技首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	保荐机构、保荐代表人应当协助和督促上	保荐机构已协助和督促上市公司建立

	工作内容	持续督导情况
	市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
2	<p>保荐机构、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。</p>	<p>保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。</p> <p>保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。</p> <p>保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。</p>
3	<p>上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。</p>	<p>本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。</p> <p>上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。</p>
4	保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
5	<p>保荐机构、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。</p> <p>保荐机构、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐机构、保荐代表人应当发表意见予以说明。</p>	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、查阅相关公开信息进行尽职调查等方式，了解顾中科技经营、股票交易等情况，对顾中科技开展持续督导工作。经核查，本持续督导期内，上市公司不存在持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项。

	工作内容	持续督导情况
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
7	保荐机构、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
8	保荐机构、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐机构对上市公司募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查，出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现硕中科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术及产品升级迭代的风险

随着全球集成电路行业的不断发展及终端应用产品对集成电路相关性能的要求不断提高，集成电路对端口密度、信号延迟及封装体积等提出了越来越高的要求。以显示驱动芯片为例，一方面，显示屏幕分辨率、清晰度的提升意味着更多 I/O 数量，对凸块制造的密度、间距提出越来越高的要求，测试的复杂性也随之提升，后段封装的精准度和难度也大幅增加；另一方面，AMOLED、Mini Led、Micro Led 等新型显示技术正处于发展阶段，相关新型显示技术对已有显示技术的升级迭代将间接对显示驱动芯片封测技术产生一定影响。

如果公司无法根据行业发展趋势和下游客户需求进行技术与产品创新，或新开发的产品质量未能得到客户认可，或研发项目无法顺利实现商业化，将可能面临订单流失、市场地位下降的风险，从而对公司的核心竞争力造成不利影响。

2、研发技术人才流失风险

集成电路封测行业是典型的技术密集行业，企业的技术研发实力源于对专业人才的储备和培养。虽然近几年中国大陆集成电路封测行业取得快速发展，从业人员逐步增多，但专业研发人才供不应求的情况依然普遍存在。由于近几年市场对于集成电路封测高端人才的需求急剧增加，人才招聘成本不断上升，未来一段时间，专业人才相对缺乏仍将成为制约行业发展的重要因素之一。若公司核心技术人才流失，将对公司的研发生产造成不利影响。

（二）经营风险

1、毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率 28.56%，较去年同期略有下滑，公司显示驱动芯片、多元化芯片封测业务下游应用领域主要为高清电视、智能手机、笔记本电脑等，对宏观经济形势较为敏感。如果未来宏观经济形势发生变化，下游应用领域发展不达预期，行业规模增速放缓或出现下滑，可能对公司产品市场需求、销售价格产生负面影响，进而导致公司毛利率下滑，影响公司的盈利能力及业绩表现。

2、多元化芯片开拓不利的风险

公司从 2015 年开始布局铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等多元化芯片先进封装技术的研发，并于 2019 年完成后段 DPS 封装的建置，目前正在建置正面金属化工艺（FSM）&晶圆减薄-背面研磨/背面金属化（BGBM）的制程，公司多元化芯片虽增长较快但整体规模相对较小，非全制程占比较高，且主要集中在电源管理、射频前端等芯片领域，客户主要集中在中国境内，与长电科技、通富微电、华天科技等头部综合类封测企业相比综合实力具有较大差距。若综合类封测企业对相关细分领域进行大规模投入、多元化芯片客户导入不及预期或下游终端市场环境出现不利变化等情况，则存在多元化芯片封测业务开拓不利的风险。

（三）财务风险

1、汇率波动风险

公司存在部分境外销售及境外采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算。未来若人民币与美元或美元与日元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

2、存货跌价风险

报告期，公司存货账面价值为 61,147.76 万元，占期末资产总额的比重为 7.64%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长。如果未来市场需求、价格发生不利变动，公司将面临存货跌价的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

3、商誉减值风险

2018 年 1 月，公司收购苏州硕中形成商誉 88,748.48 万元。报告期内，苏州硕中系公司封装测试业务主要经营主体，如果未来封装测试市场需求、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，而苏州硕中未能适应前述变化，则可能对苏州硕中的盈利能力产生不利影响，进而可能使公司面临商誉减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、税收优惠存在不确定性的风险

报告期内，公司子公司苏州硕中享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率，若未来上述税收优惠政策发生变化或者子公司苏州硕中不再符合税收优惠条件，则可能对公司的经营业绩和盈利产生不利影响。

5、政府补助政策变化风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为 3,623.95 万元。集成电路行业系国家重点战略产业，目前各级政府或主管部门给予的补助政策较多，如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生一定的影响。

6、国际贸易风险

报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比例为 29.13%，主要集中于中国台湾、中国香港及新加坡等国家或地区，报告期内，上述国家或地区相关进口政策未发生重大变化，针对公司主要产品不存在特殊的限制政策。如果未来公司外销客户所在国家或地区与中国的区域贸易政策发生不利变化，如限制进出口或提高关税，则公司可能面临境外客户流失、外销收入下滑等情形，将对公司

的业务和经营产生不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

近年来，各大封测厂商积极布局先进封装业务，在显示驱动芯片封测领域，除细分行业龙头硕邦科技、南茂科技继续在相关领域保持领先地位外，综合类封测企业通过自建或与其他方合作等方式对相关领域也进行积极布局。相较于行业内头部封测企业，公司在资产规模、资本实力、产品服务范围等方面存在一定差距，面对行业竞争加剧的局面，若公司不能较好地采取措施应对，可能会对公司业务开拓以及经营业绩产生不利影响。

2、行业波动及需求变化风险

近年，全球半导体市场面临的激烈竞争以及地缘政治等不确定因素的影响，对集成电路行业的盈利空间造成了一定程度的冲击。公司主营业务为集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品，集成电路行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。集成电路行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球集成电路产业市场出现较大波动，将对公司经营业绩带来一定的影响。

3、产业政策变化的风险

公司所处的集成电路行业是国家重点鼓励发展的领域之一。国家陆续出台了包括《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等多项产业政策，促进集成电路行业发展；在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权、进出口等方面给予一系列优惠措施，以推动集成电路行业的健康发展，如未来上述产业政策出现不利变化，将对公司的业务产生一定不利影响。

（五）宏观环境风险

目前，国际贸易摩擦不断，全球半导体市场面临较大压力，半导体产业仍处于周期性波动中，公司主营业务为集成电路封装测试服务，具有较强的周期性。

例如，下游显示面板行业具有周期性较强、价格波动较大的特点，间接对显示驱动芯片及相关封测需求产生较大影响。同时，显示驱动芯片、电源管理芯片以及射频前端芯片等产品的下游终端主要为消费类电子，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、高清电视、智能穿戴等，相关产品性能更新速度快、品牌及规格型号繁多使得需求变化较大，存在不确定性。未来，若全球经济增速放缓，可能导致消费者消费不如预期，进而持续影响半导体行业，对公司生产经营产生不利的影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，硕中科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,190,261,246.45	1,959,375,628.33	11.78
归属于上市公司股东的净利润	265,790,812.36	313,276,970.57	-15.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,793,438.00	276,676,779.67	-10.44
经营活动产生的现金流量净额	611,000,524.92	690,346,690.70	-11.49
主要会计数据	2025年末	2024年末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,115,968,766.39	6,003,292,022.20	1.88
总资产	8,001,256,841.71	6,991,013,658.68	14.45

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.22	0.26	-15.38
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.26	-15.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	-8.70
加权平均净资产收益	4.38	5.29	减少 0.91 个百分点

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.08	4.67	减少 0.59 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.94	7.89	增加 1.05 个百分点

2025 年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、报告期内，营业收入同比上升 11.78%，主要系市场行情回温，客户订单量增加所致。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降 15.16%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 10.44%，主要系设备折旧及人力成本、汇兑净损失及公司对技术、工艺等进行持续的开发投入等较上年同期增加所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 11.49%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

4、报告期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降，主要系本期净利润下降所致。

5、报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降，主要系本期净利润下降所致。

6、报告期研发投入占营业收入的比例同比上升，主要系公司持续加大研发投入，提升核心技术，丰富产品结构所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）深厚的技术积累和扎实的研发实力

公司一贯坚持自主创新和精益求精的理念，始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要举措。就显示驱动芯片封测业务而言，作为境内规模最大、进入时间最早的显示驱动芯片封测厂商之一，公司在“微细间距金凸块高可靠性制造”、“大尺寸高平坦化电镀”、“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”等凸块制造技术

以及“高精度高密度内引脚接合”、“125mm 大版面覆晶封装技术”、“高稳定性晶圆研磨切割技术”等后段封装技术方面积累了较多成功经验和技術成果，同时在高端设备技术改造、自动化系统方面具有较强实力，相关技术覆盖了整个生产制程，为公司产品保持较高竞争力提供了坚实保障。目前，公司已具备业内最先进 28nm 制程显示驱动芯片的封装测试能力。领先的技术优势及丰富的产品特点有助于公司在显示驱动芯片封装测试业务中保持较高的客户粘性和定价能力。

得益于公司在显示驱动芯片封装测试领域积累的丰富经验，公司在多元化芯片封装测试领域的技术研发中也取得了阶段性成果，相继开发出铜镍金、铜柱、锡等金属凸块制造技术。其中，铜柱凸块可代替传统的打线封装，通过缩短连接电路的长度，以减小芯片封装面积和体积，从而克服芯片系统的寄生电容干扰、电阻发热和信号延迟等缺点；铜镍金凸块可通过重布线技术，在不改变前端芯片内部设计结构的情况下，在封装环节进一步优化芯片的线路布局，以低成本的方式实现降低芯片导通电阻、提升电性能的效果；锡凸块具有密度大、间距小、低感应、散热能力佳的特点，适用于细微间距的芯片产品，市场空间较大。同时，面对“后摩尔时代”芯片尺寸越来越小、电性能要求越来越高的技术发展趋势，公司建立了 DPS 和载板覆晶封装制程，助力实现更小尺寸和更高集成度的整套封装测试的解决方案。同时，公司依托在金属凸块技术方面的深厚积累，积极布局功率芯片前段正面金属化（FSM）、背面减薄及金属化（BGBM）工艺以及后段铜片夹扣键合（Cu Clip）封装工艺，以满足功率器件大电流、低导通阻抗的特性。

（二）丰富的客户资源及完善的质量管理体系

公司凭借领先的技术实力和稳定的产品质量，在显示驱动芯片封装测试领域积累了大量优质客户资源。在境外客户方面，公司与联咏科技、奇景光电、瑞鼎科技、敦泰电子、谱瑞科技等国际知名显示驱动芯片设计公司建立了长期稳定的合作关系。这些客户在全球显示驱动芯片市场占据重要地位。在境内客户方面，公司长期服务了集创北方、奕斯伟计算、格科微、云英谷、豪威科技、通锐微等快速成长的本土企业，随着国产化进程加快，这些本土企业的市场份额持续提升。

公司采取“客户优先”的服务战略，建立了专业的客户服务团队。在新产品导入阶段，公司技术团队提前介入客户的产品开发过程，协助客户优化产品设计，缩短产品开发周期。在量产阶段，公司能够根据客户需求快速调整生产计划，确

保及时交付。这种深度合作模式显著增强了客户粘性，多家重要客户已与公司建立了战略合作关系，并获得客户广泛赞誉。公司正在积极开发新的客户资源，未来将进一步扩大客户群体，为产能消化提供更广阔的市场空间。

在质量管理体系方面，公司通过了 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系等多项国际认证。目前公司在 Bumping、CP、COG 与 COF 等各主要环节的良率均高于行业平均水平。公司还开发并实施了 MES（制造执行系统）等现代化信息管理系统，实现了生产过程的实时监控和精细化管理，为大规模产能扩充奠定了管理基础。

（三）高效的生产效率

随着显示芯片封装市场的快速发展，生产效率的提升已成为行业领先企业保持竞争优势的重要因素，提升生产效率、优化资源配置已成为公司扩展产能、提升竞争力的关键。

公司有更为先进的自动化生产设备和智能化管理系统。在生产设备方面，先进的高精度封装设备可提升生产的自动化水平，减少人工干预带来的不确定性。在生产管理方面，将通过智能化系统实现生产过程的实时监控和精细化管理，优化生产排程，提高设备利用率。这些升级将帮助公司在保证产品质量的同时，显著提升生产效率，缩短产品交付周期。

此外，自动化和智能化水平的提升还将带来显著的成本优势。通过减少人工成本、提高材料利用率、降低能源消耗等方式，优化公司的成本结构。

（四）经验丰富及稳定的管理团队

公司深耕集成电路封装测试行业数十年，在显示驱动芯片封测领域积累了丰富的运营管理经验。通过多年的实践和探索，公司建立了一套完整的生产运营管理体系，涵盖从产品研发、生产制造到品质管控的全流程。特别是在产能扩充项目管理方面，公司已成功完成多次重大产线建设，积累了丰富的项目实施经验。公司核心管理团队保持高度稳定，多位高管在显示驱动芯片封测领域拥有 15 年以上从业经验。通过实施员工持股计划等长效激励机制，公司建立了一支专业能力突出、执行力强的运营团队。稳定的管理团队和完善的管理体系，将有效保障公司的顺利运营。

七、研发支出变化及研发进展

公司始终重视研发体系建设、坚持以市场为导向，与客户紧密合作，坚持对技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障，建立了高素质的管理团队和专业化的核心研发团队。报告期内，公司研发投入 19,578.77 万元，较上年同期增长 26.57%。截至报告期末，公司研发人员数量增至 315 人，较上年同期增长 10.92%，研发人员数量占公司比例为 13.04%。

2025 年，公司获得授权发明专利 18 项（中国 9 项，国际 9 项）、授权实用新型专利 22 项，包括晶圆防反装置、晶圆对中装置、芯片托盘的翻盘装置、散热辅助片及具有其的薄膜覆晶封装结构、芯片制造设备、晶圆弹匣放置机构及具有其的内引脚接合装置、芯片托盘的翻盘装置、芯片料带压紧装置等均为自主研发，且上述技术大部分已在公司产品上实现了应用。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 39,883,344.96 元，其中：募集资金理财产品收益 0.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 34,277,829.79 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下表：

单位：万元	
项目	金额
2023 年 4 月 13 日实际到账募集资金金额	226,560.00
减：支付的其他发行费用	3,297.38
募集资金净额	223,262.62
减：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	24,873.31
减：募投项目支出	173,325.92
减：超募资金永久补充流动资金	13,800.00
减：回购股份支出	9,462.62
加：募集资金理财产品收益金额	-

加：累计利息收入扣除手续费净额	3,427.78
减：利息收入投入募投项目支出	1,240.22
2025年12月31日募集资金余额	3,988.33
减：期末未到期理财产品	-
实际募集资金专户余额	3,988.33

公司“颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额481.34万元，其中待支付给供应商金额0.00万元，预计节余资金481.34万元，计划用于永久补充流动资金。

公司“颀中先进封装测试生产基地项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额3,285.02万元，其中待支付给供应商金额286.53万元，预计节余资金2,998.49万元，计划用于永久补充流动资金。

公司“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至2025年12月31日，募集资金账户余额221.97万元，其中待支付给供应商金额155.27万元，预计节余资金66.70万元，计划用于永久补充流动资金。

2025年6月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2025年6月19日、2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。

（二）2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至2025年12月31日，公司可转换债券实际募集资金专户余额为人民币768,143,573.98元，其中：募集资金理财产品收益0.00元，累计利息收入扣除手

续费净额 439,203.24 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	85,000.00
扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销费用	600.00
2025 年 11 月 7 日实际到账募集资金金额	84,400.00
减：支付的其他发行费用	51.89
募集资金净额	84,348.11
减：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	-
减：募投项目支出	7,577.68
加：募集资金理财产品收益金额	-
加：累计利息收入扣除手续费净额	43.92
减：利息收入投入募投项目支出	-
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	76,814.36
减：期末未到期理财产品	-
实际募集资金专户余额	76,814.36

公司 2025 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

1、实际控制人

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、控股股东

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东合肥硕中科技控股有限公司持有公司 397,127,159 股，持股比例为 33.40%。

3、董事和高级管理人员

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事和高级管理人员的持股情况如下：

序号	名称	任职	持股数量（股）	持股比例
1	陈小蓓	董事长	-	-
2	赵章华	董事	-	-
3	黄玲	董事	-	-
4	罗世蔚	董事	-	-
5	崔也光	独立董事	-	-
6	王新	独立董事	-	-
7	胡晓林	独立董事（离任）	-	-
8	解光军	独立董事	-	-
9	杨宗铭	董事、总经理、核心技术人员	1,799,867	0.15%
10	余成强	职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	614,195	0.05%
11	张玲玲	副总经理	-	-
12	周小青	副总经理	463,541	0.04%
13	朱晓玲	副总经理	-	-
14	王小锋	核心技术人员	464,480	0.04%
15	戴磊	核心技术人员	-	-

注：本表中列示的董事和高级管理人员持股数量为直接持股数量。

除上述持有公司股份外，公司董事和高级管理人员均未以其它方式直接或间接持有公司股份。

（二）质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人和董事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于合肥硕中科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

吴建航

吴建航

廖小龙

廖小龙

